



CIESでは、
集積エレクトロニクス産業に資するため、
国際産学連携研究による革新的省エネルギー
集積エレクトロニクスの創出を目指しています。
最新の研究成果をご報告するため、
第1回成果報告会を開催致します。

1st CIES Technology Forum March 19-20, 2015 DAY.2

2015年3月20日(金)
大手町サンケイプラザ 3F

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2
TEL 03-3273-2258

主催者挨拶	里見 進	東北大学	
来賓挨拶	久間和生	総合科学技術・イノベーション会議	
	安永裕幸	経済産業省	岸本康夫 文部科学省
概要説明	遠藤哲郎	東北大学	
成果報告	青木孝文	東北大学	安藤康夫 東北大学
	池田正二	東北大学	遠藤哲郎 東北大学
	大嶋洋一	東北大学	亀山充隆 東北大学
	佐橋政司	東北大学	羽生貴弘 東北大学
	丹羽正昭	東北大学	
閉会挨拶	品田高宏	東北大学	

後援 (予定) 文部科学省、経済産業省、科学技術振興機構、
新エネルギー・産業技術総合開発機構

参加お申し込み

http://www.cies.tohoku.ac.jp/1st_forum/entry.html

参加費: 無 料

申し込み期限:
2015年3月9日

お問い合わせ
東北大学国際集積エレクトロニクス
研究開発センター

〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
TEL 022-796-3410 FAX 022-796-3432
support-office@cies.tohoku.ac.jp

1st CIES Technology Forum

March 19-20, 2015

2015年3月20日 研究成果報告会
大手町サンケイプラザ 3F

DAY.2

9:00-9:30	主催者挨拶 来賓挨拶 総合科学技術・イノベーション会議 議員 来賓挨拶 経済産業省 産業技術環境局 審議官 来賓挨拶 文部科学省 科学技術・学術政策局 次長	里見 進 (東北大学) 久間和生 (総合科学技術・イノベーション会議) 安永裕幸 (経済産業省) 岸本康夫 (文部科学省)
9:30-10:10	CIES の概要説明 コンソーシアムプログラム 1 不揮発性ワーキングメモリを目指した STT-MRAM の研究開発	遠藤哲郎 (東北大学)
10:10-10:40	①材料・素子開発	池田正二 (東北大学)
10:40-11:00	②集積プロセス STT-MRAM 開発	遠藤哲郎 (東北大学)
11:00-11:30	コンソーシアムプログラム 2 不揮発記憶ベース低消費電力・高性能 VLSI プロセッサの自動設計環境の研究開発	羽生貴弘 (東北大学)
11:30-12:00	コンソーシアムプログラム 3 強磁性トンネル接合素子を用いた高感度磁気センサの開発	安藤康夫 (東北大学)
12:00-14:00	昼食	
14:00-14:30	コンソーシアムプログラム 4 超小型・省電力フルスピン 3次元ワイヤレス SESUB の研究開発	佐橋政司 (東北大学)
14:30-15:00	コンソーシアムプログラム 5 次世代移動体およびアプリケーション向けの画像処理技術の基盤研究	
	コンソーシアムプログラム 6 組込みシステムセキュリティ技術の研究開発	青木孝文 (東北大学)
15:00-15:30	コンソーシアムプログラム 7 リアルワールド応用知能システム VLSI プラットフォームの研究開発	亀山充隆 (東北大学)
15:30-15:50	休憩	
15:50-16:20	JST ACCEL 縦型 BC-MOSFET による三次元集積工学と応用展開	遠藤哲郎 (東北大学)
16:20-16:50	パワーデバイスプロジェクト インテリジェントパワーデバイスを目指したハイブリッド化の基盤研究	丹羽正昭 (東北大学)
16:50-17:10	CIES の知財を活用した産学連携への取り組み	大嶋洋一 (東北大学)
17:10-17:20	閉会挨拶	品田高宏 (東北大学)

お問い合わせ **東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター**

〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1

TEL 022-796-3410 FAX 022-796-3432 support-office@cies.tohoku.ac.jp



CIES will hold
1st CIES Technology Forum to
introduce our mission, vision and R&D activities
for the first time.

Technology

March 20, 2015

Otemachi Sankei Plaza (3F)

1-7-2 Otemachi Chiyoda-ku Tokyo-to
Phone No.03-3273-2258

1st CIES

Forum

March 19-20, 2015

DAY.2

Welcome address	Susumu Satomi (Tohoku Univ.)
Address	Kazuo Kyuma (CSTI)
	Yuuko Yasunaga (METI)
	Yasuo Kishimoto (MEXT)
CIES overview	Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.)
Progress report	Takafumi Aoki (Tohoku Univ.)
	Yasuo Ando (Tohoku Univ.)
	Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.)
	Takahiro Hanyu (Tohoku Univ.)
	Shoji Ikeda (Tohoku Univ.)
	Michitaka Kameyama (Tohoku Univ.)
	Masaaki Niwa (Tohoku Univ.)
	Yoichi Ohshima (Tohoku Univ.)
	Masashi Sahashi (Tohoku Univ.)
Closing Remarks	Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)

Sponsors / Organizations (TBD) MEXT, METI, JST, NEDO

Registration

[http://www.cies.tohoku.ac.jp/
1st_forum/entry.html](http://www.cies.tohoku.ac.jp/1st_forum/entry.html)

Registration fee: free

Registration Deadline:

March 9, 2015

Inquiry

**Tohoku University,
Center for Innovative Integrated
Electronic Systems**

468-1 Aramaki Aza Aoba, Aoba-ku, Sendai, Miyagi
980-0845, JAPAN

TEL +81-22-796-3410 FAX +81-22-796-3432
support-office@cies.tohoku.ac.jp

www.cies.tohoku.ac.jp

1st CIES Technology Forum

March 19-20, 2015

March 20, 2015 Progress Report
Otemachi Sankei Plaza (3F)

DAY.2

	Welcome address	Susumu Satomi (Tohoku Univ.)
	Address Executive Member, Council for Science and Technology and Innovation	Kazuo Kyuma (CSTI)
9:00-9:30	Address Deputy Director-General, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, METI	Yuuko Yasunaga (METI)
	Address Senior Deputy Director-General, Science and Technology Policy Bureau, MEXT	Yasuo Kishimoto (MEXT)
9:30-10:10	CIES Overview	Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.)
10:10-10:40	Consortium Program1 STT-MRAM aimed at developing non-volatile working memory and its manufacturing technologies (1) Materials & device development	Shoji Ikeda (Tohoku Univ.)
10:40-11:00	Consortium Program1 STT-MRAM aimed at developing non-volatile working memory and its manufacturing technologies (2) Integrated process development	Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.)
11:00-11:30	Consortium Program2 Technologies to automatically design environments for low-energy consumption and highly functional VLSI processors based on non-volatile memory	Takahiro Hanyu (Tohoku Univ.)
11:30-12:00	Consortium Program3 Supersensitive magnetic sensors using ferromagnetic tunnel junctions	Yasuo Ando (Tohoku Univ.)
12:00-14:00	Lunch	
14:00-14:30	Consortium Program4 Ultra-small full-spin 3-D wireless semiconductor embedded substrate (SESUB) technologies featuring power saving	Masashi Sahashi (Tohoku Univ.)
14:30-15:00	Consortium Program5 Basic research on image processing technology for next generation automobiles and information appliances	Takafumi Aoki (Tohoku Univ.)
	Consortium Program6 Embedded security technology	
15:00-15:30	Consortium Program7 VLSI platform for real-world intelligent integrated systems	Michitaka Kameyama (Tohoku Univ.)
15:30-15:50	Break	
15:50-16:20	JST ACCEL Three-dimensional integrated circuits technology based on vertical BC-MOSFET and its advanced application exploration	Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.)
16:20-16:50	Power Device Project Basic research on hybridization for intelligent power devices	Masaaki Niwa (Tohoku Univ.)
16:50-17:10	Activities for academic industry cooperation utilizing CIES IPs	Yoichi Ohshima (Tohoku Univ.)
17:10-17:20	Closing remarks	Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)

Inquiry **Tohoku University,**
Center for Innovative Integrated Electronic Systems

468-1 Aramaki Aza Aoba, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-0845, JAPAN
TEL +81-22-796-3410 FAX +81-22-796-3432
support-office@cies.tohoku.ac.jp

Sponsors / Organizations(TBD): MEXT, METI, JST, NEDO